

2008年3月期 中間決算説明会

株式会社ディスコ

2007年11月13日
大和コンファレンスホール

「見通し」に関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動等があります。

本日の説明

1. 2008年3月期中間決算概要

常務取締役 IR担当

関家圭三

2. 事業の展開と今期の見通し

代表取締役社長

溝呂木 齊

3. 質疑応答

本日の説明

1. 2008年3月期中間決算概要

常務取締役 IR担当

関家圭三

2. 事業の展開と今期の見通し

代表取締役社長

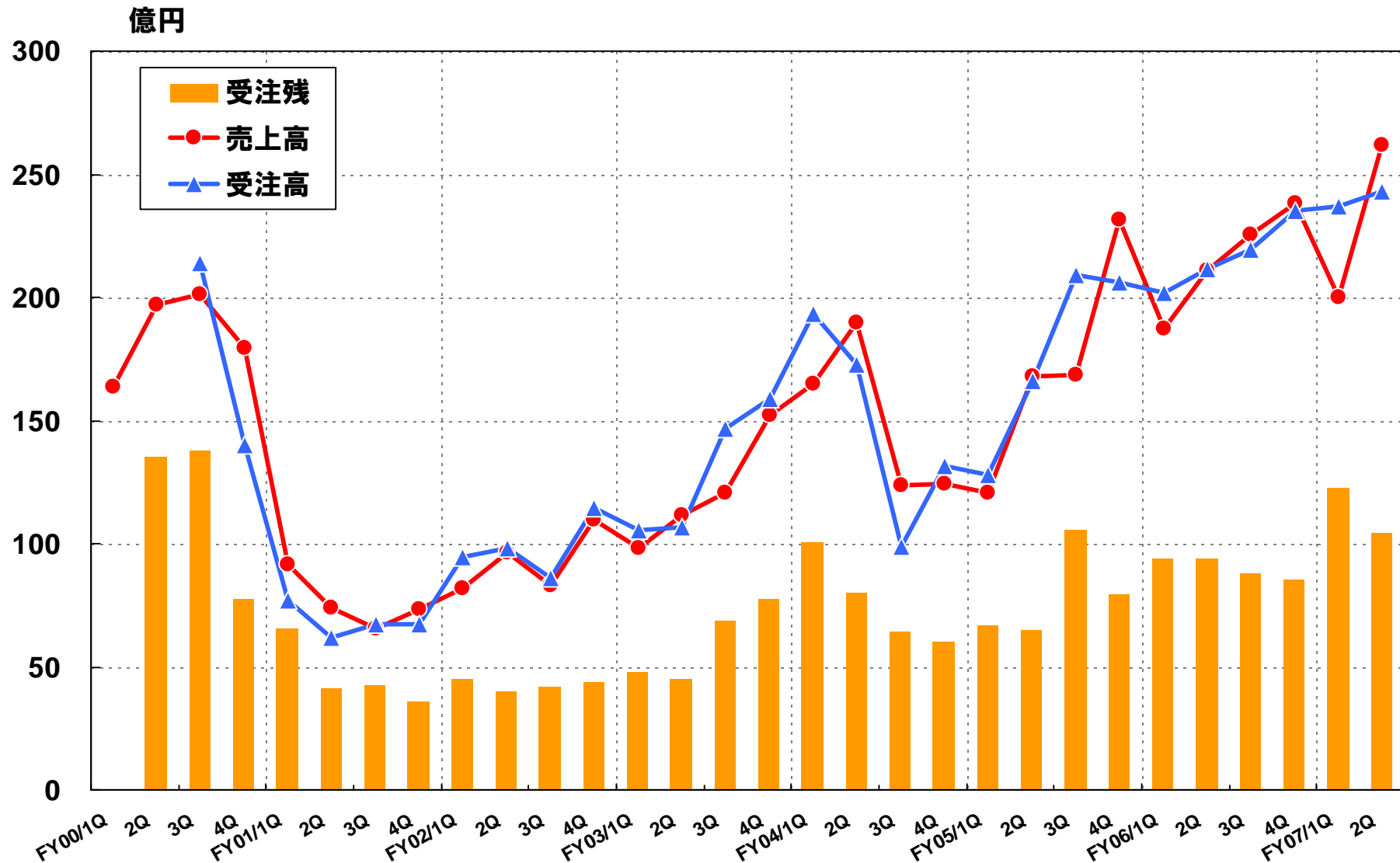
溝呂木 齊

3. 質疑応答

2008年3月期中間決算概要

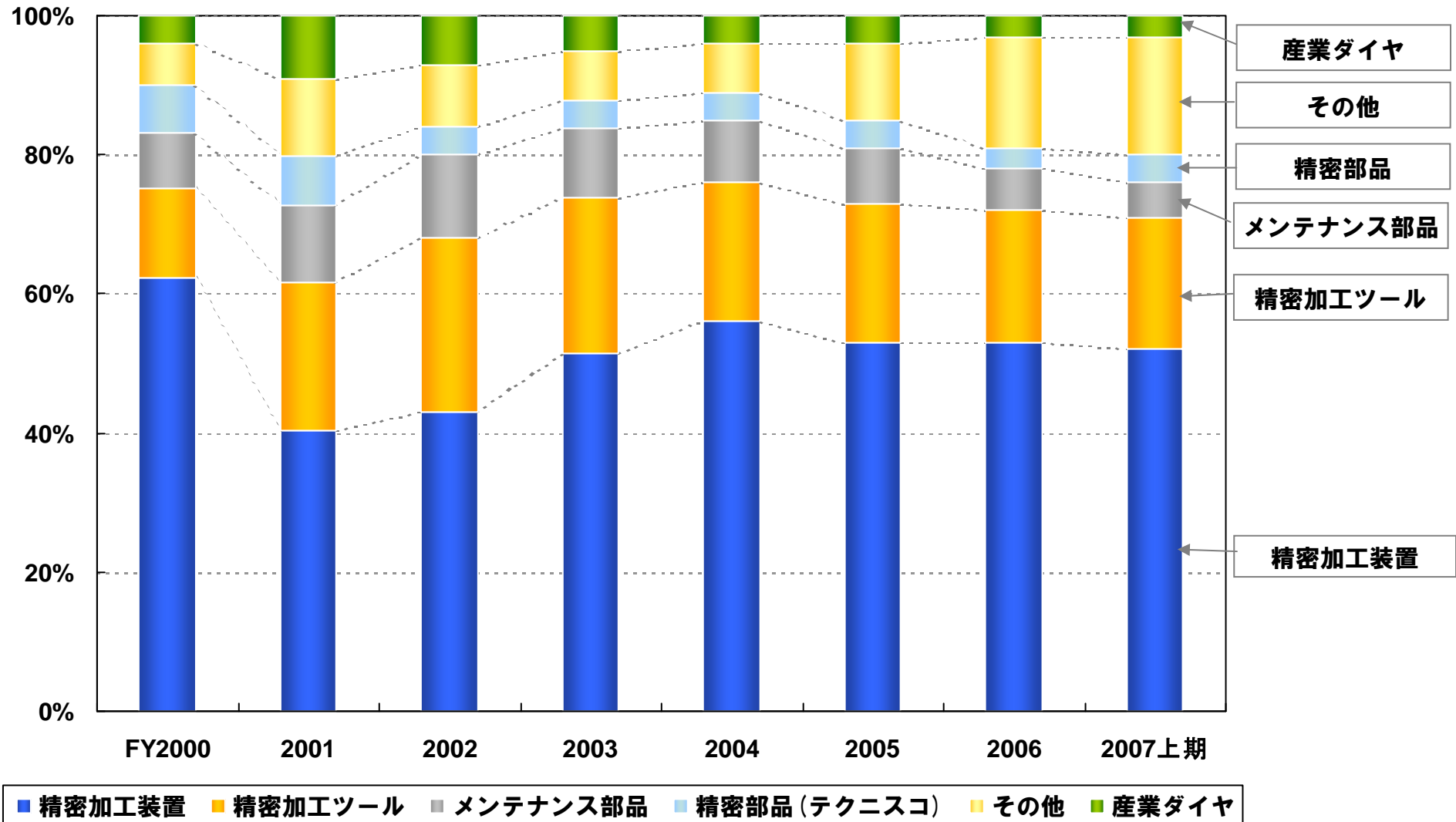
(単位: 億円 四捨五入)	2006年度		2007年度		
	中間期	通期	中間期	前年同期比 (%)	
売上高	398	861	461	15.9%	過去最高の前下期とほぼ同水準
売上総利益	211	440	238	-	
GP率	53.0%	51.1%	51.6%	-1.4pt	
営業利益	95	195	110	15.0%	営業外費用: 為替差損2億円
経常利益	95	196	110	16.0%	
経常利益率	23.9%	22.8%	23.9%	0pt	
税引き前利益	92	177	110	-	海外子会社の清算にかかわる繰延べ税金資産の取り崩し5億円
当期純利益	55	109	62	11.6%	
一株あたり利益(円)	163.45	321.22	181.98	-	
受注高	413	868	480	16.2%	過去最高を更新
受注残	94	86	104	-	

連結売上高・受注高推移



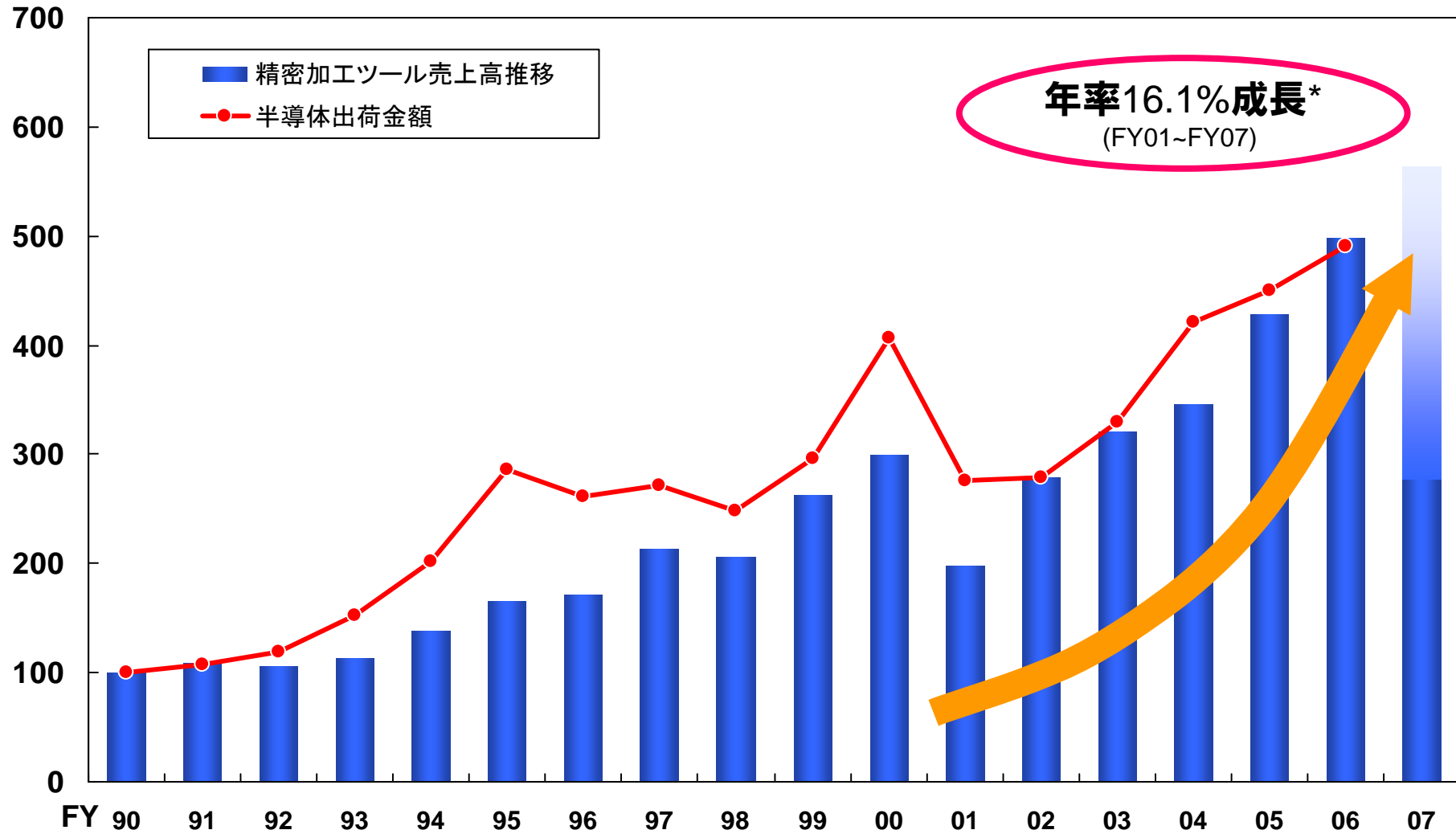
注: 2000年度第3四半期より四半期決算開示

連結売上高 製品群別構成比



精密加工ツール売上高推移

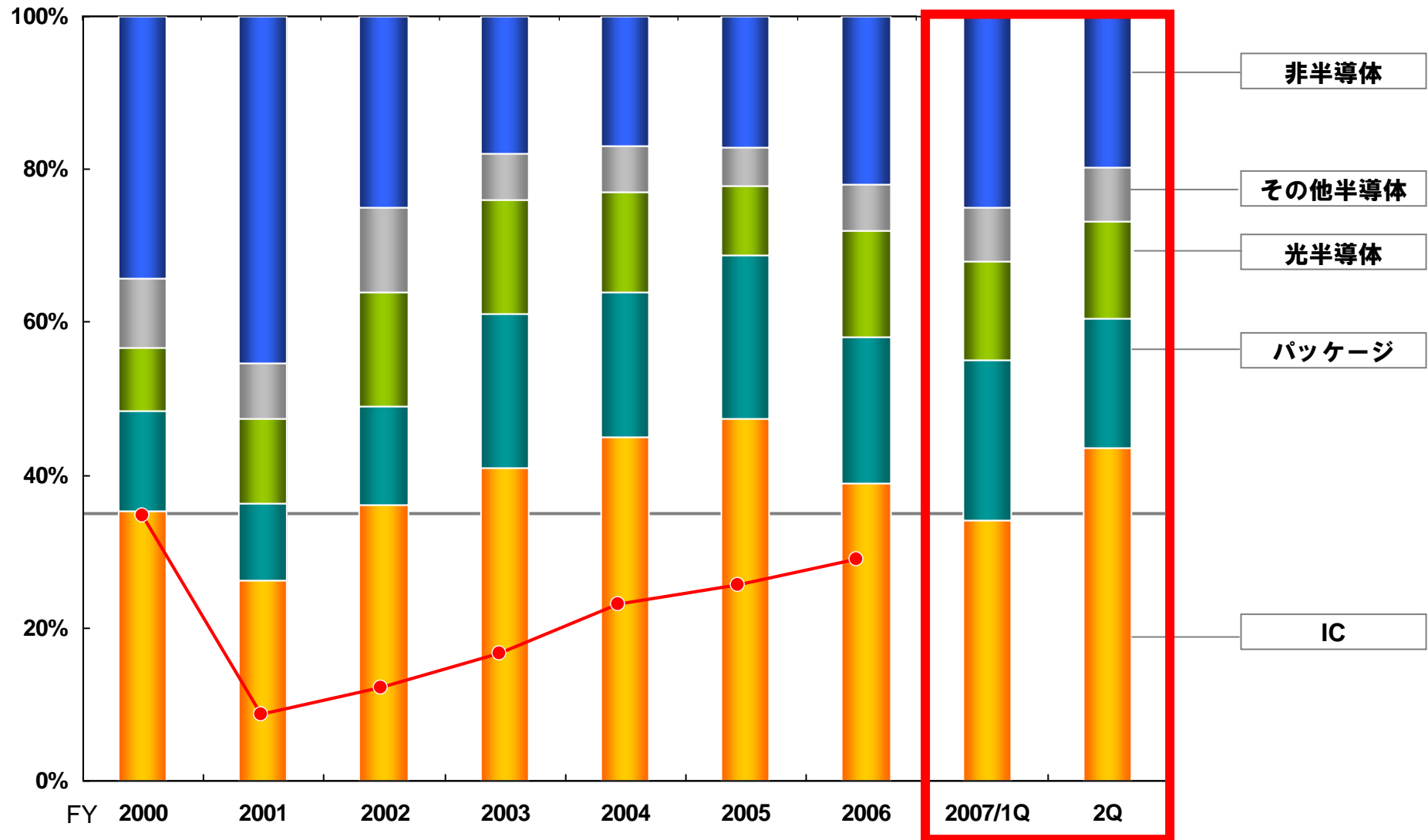
指数 FY1990=100



年率16.1%成長*
(FY01~FY07)

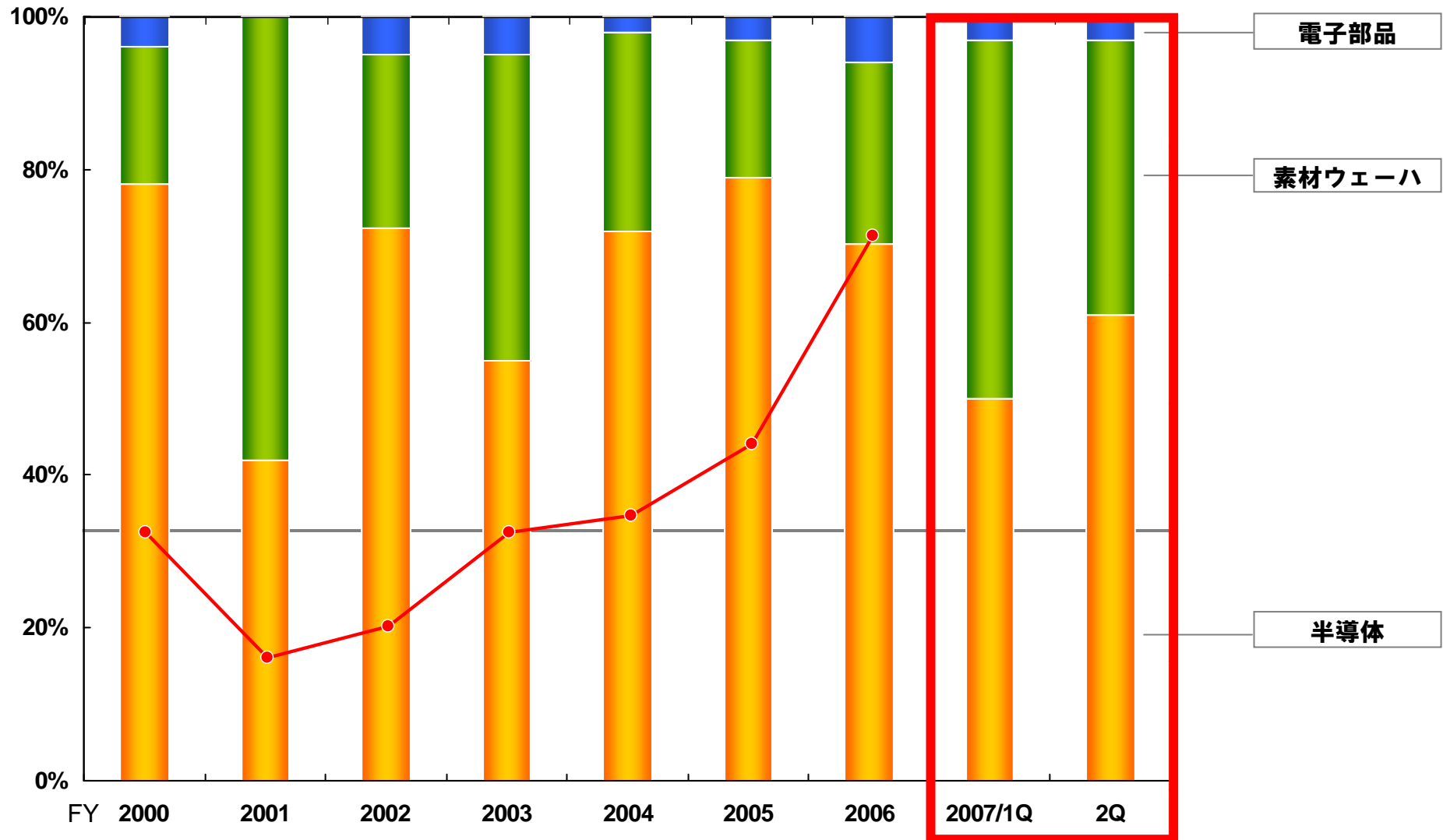
FY2007は、通期予想数値を含む

ダイサ売上構成(アプリケーション別)



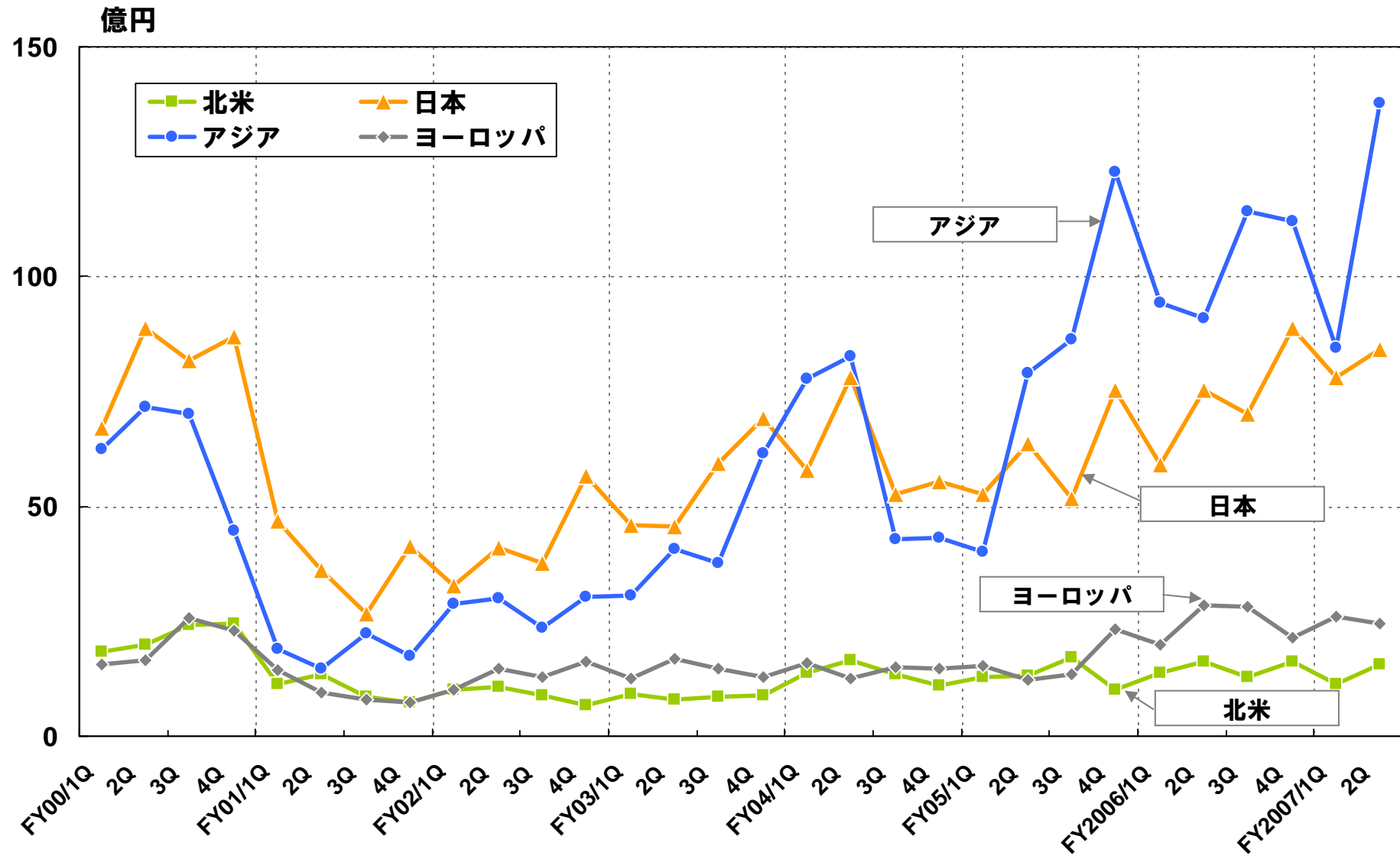
折れ線グラフ 販売金額指数 FY2000=100

グラインダ売上構成(アプリケーション別)



折れ線グラフ 販売金額指数 FY2000=100

地域別売上高推移



バランスシート(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)

	2006年度		2007年度	増減
	中間期末 (06年9月30日)	通期末 (07年3月31日)	中間期末 (07年9月31日)	2006年度末比
流動資産	682	758	731	-27
現預金	222	270	215	-56
受取手形・売掛金	252	278	304	26
棚卸資産	184	172	177	4
その他	24	38	35	-3
固定資産	365	380	445	65
有形・無形固定資産	305	345	379	34
投資その他の資産	60	35	66	31
資産合計	1,047	1,138	1,176	38
流動負債	245	288	282	-6
固定負債等	31	31	27	-4
株主資本等	771	819	867	48
自己資本比率 (%)	73.3%	71.5%	73.2%	1.7pt
負債純資産合計	1,047	1,138	1,176	38

キャッシュフロー(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)		2006年度 中間期	2007年度 中間期	2006年度通期 (12ヶ月)ご参考
営業キャッシュフロー		44	33	132
	税前純利益	93	110	177
	減価償却費	14	15	30
	売上債権・棚卸資産・仕入れ債務	-21	-31	-29
	法人税等の支払額	-37	-50	-65
	その他	-5	-12	18
投資キャッシュフロー		-37	-61	-89
	有形固定資産の取得による支出	-10	-31	-49
	定期性預金の預入による支出・収入他	-27	-30	-40
財務キャッシュフロー		-15	-19	-24
	有利子負債の減少	-3	-3	-3
	親会社による配当金の支払額	-12	-15	-22
	その他	-1	-1	1
フリーキャッシュフロー		7	-27	42
現金および現金同等物の増加額		-7	-46	20
現金および現金同等物の中間(期末)残高		212	195	240

2008年3月期業績予想

(単位: 億円 四捨五入)	中間期	下期予想	通期予想 (11月13日)	【ご参考】 2006年度 通期	対前年比
売上高	461	510	972	861	12.8%
営業利益	110	109	219	195	12.2%
営業利益率	23.9%	21.3%	22.5%	21.9%	0.6pt
経常利益	110	109	219	197	11.4%
経常利益率	23.9%	21.4%	22.6%	22.8%	0.2pt
当期純利益	62	66	128	109	17.0%
純利益率	13.4%	13.0%	13.1%	12.7%	0.4pt

(連結売上高と利益見通し)

通期売上高は過去最高を更新する972億円を予想、営業利益から当期純利益まで過去最高の更新を見込む

(法人税関連)

- ・当中間期：子会社清算にかかわる繰延べ税金資産の取り崩し5億円計上
- ・今下期に上記清算計画確定に伴う同上繰延べ資産の再計上(5億円)を見込む

(特別損失)

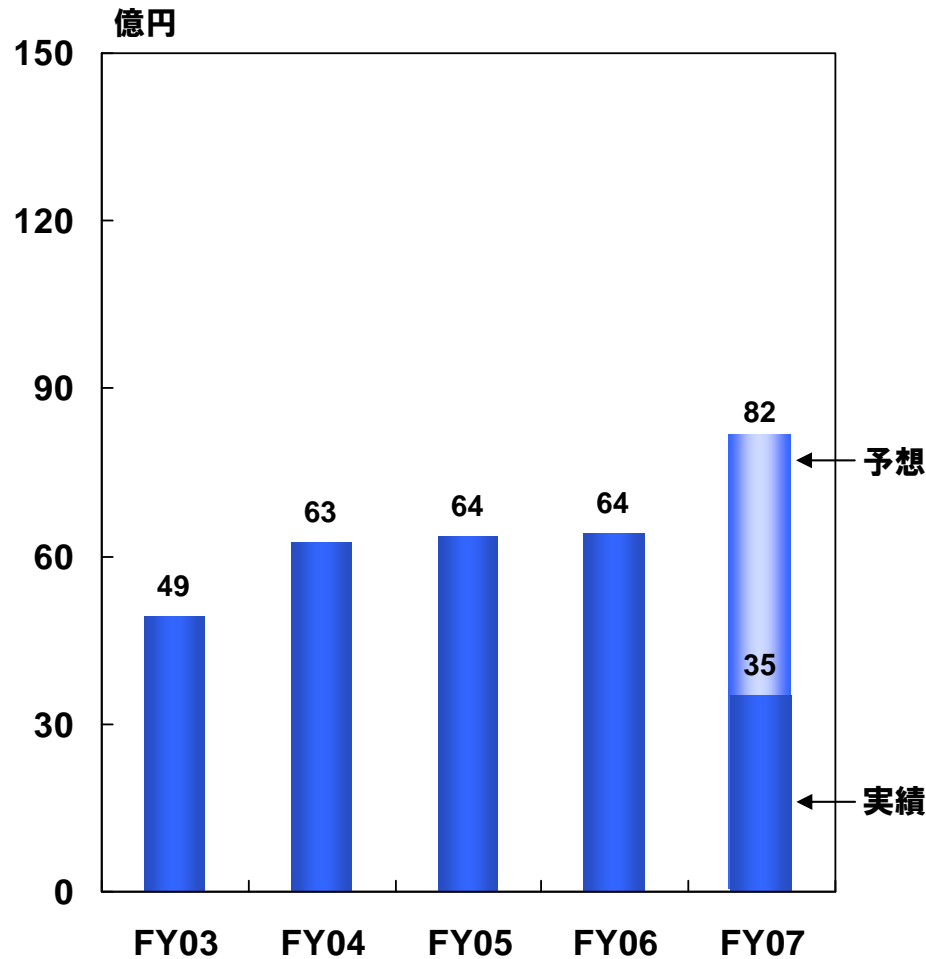
- ・棚卸資産評価損3億円 低価法対処1億円の合計4億円を下期に見込む

(為替前提)

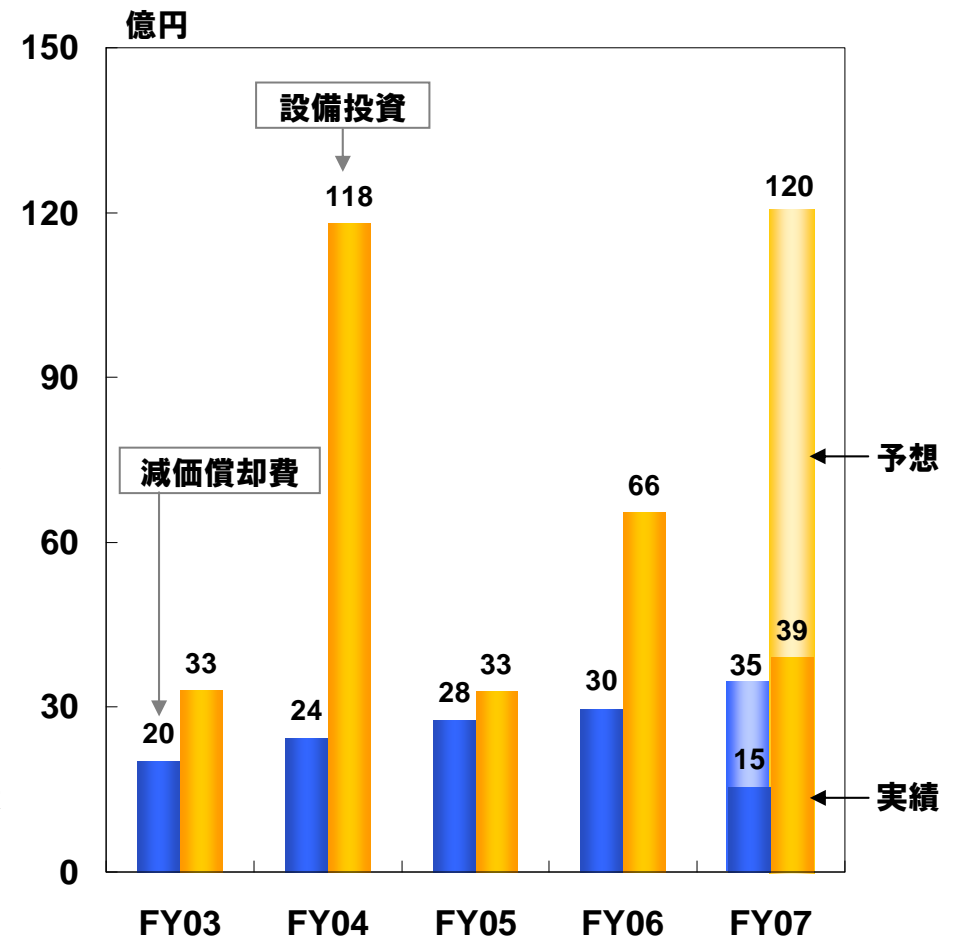
US\$:115円/EUR:155円/SGP\$:70円

連結 研究開発費/設備投資見通し

研究開発費



減価償却費・設備投資



本日の説明

1. 2008年3月期中間決算概要

常務取締役 IR担当

関家圭三

2. 事業の展開と今期の見通し

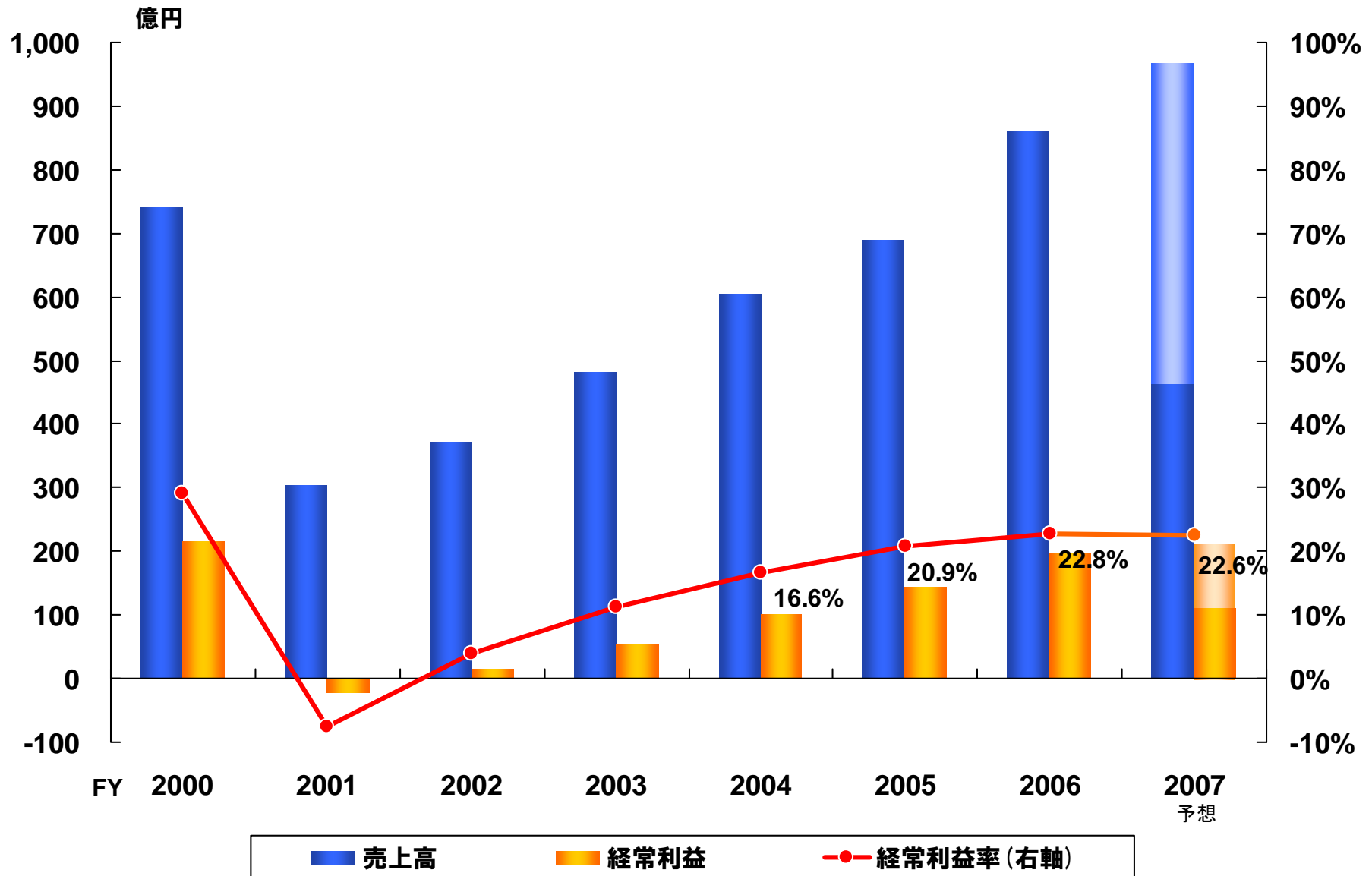
代表取締役社長

溝呂木 齊

3. 質疑応答

事業の展開について

連結業績推移



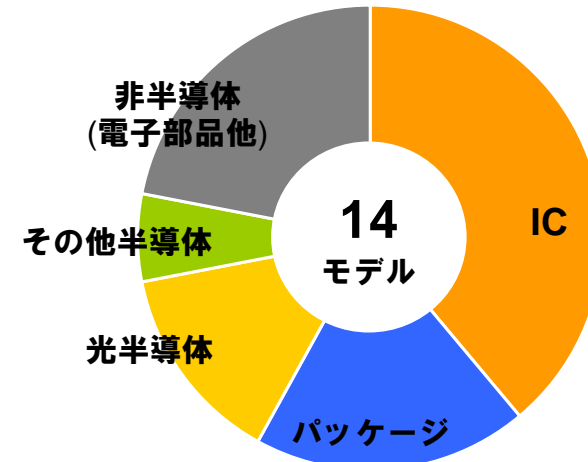
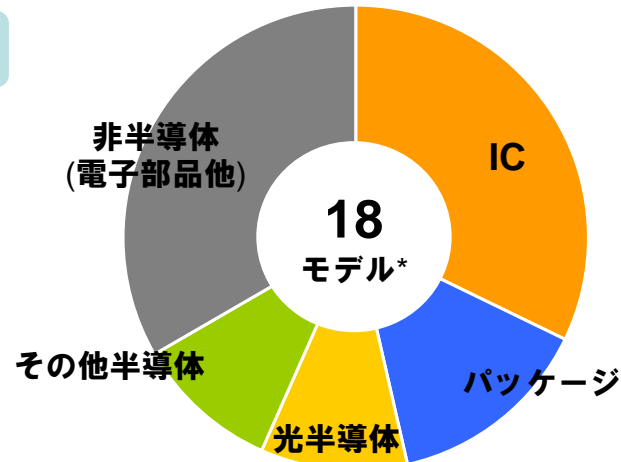
プロダクトミックスの変化

2000年度

2006年度

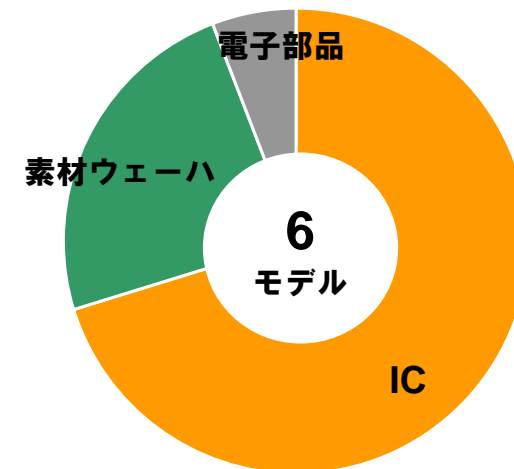
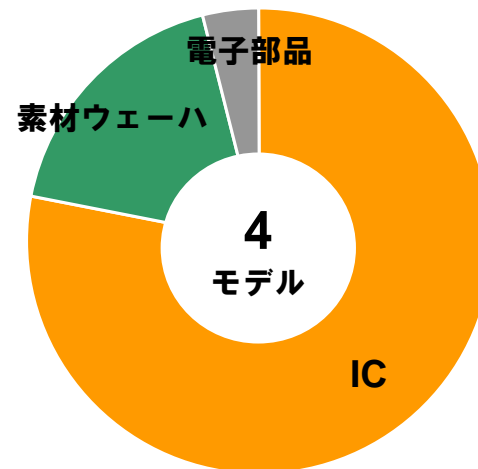
切断装置

ダイシングソー
レーザーソー



研削装置

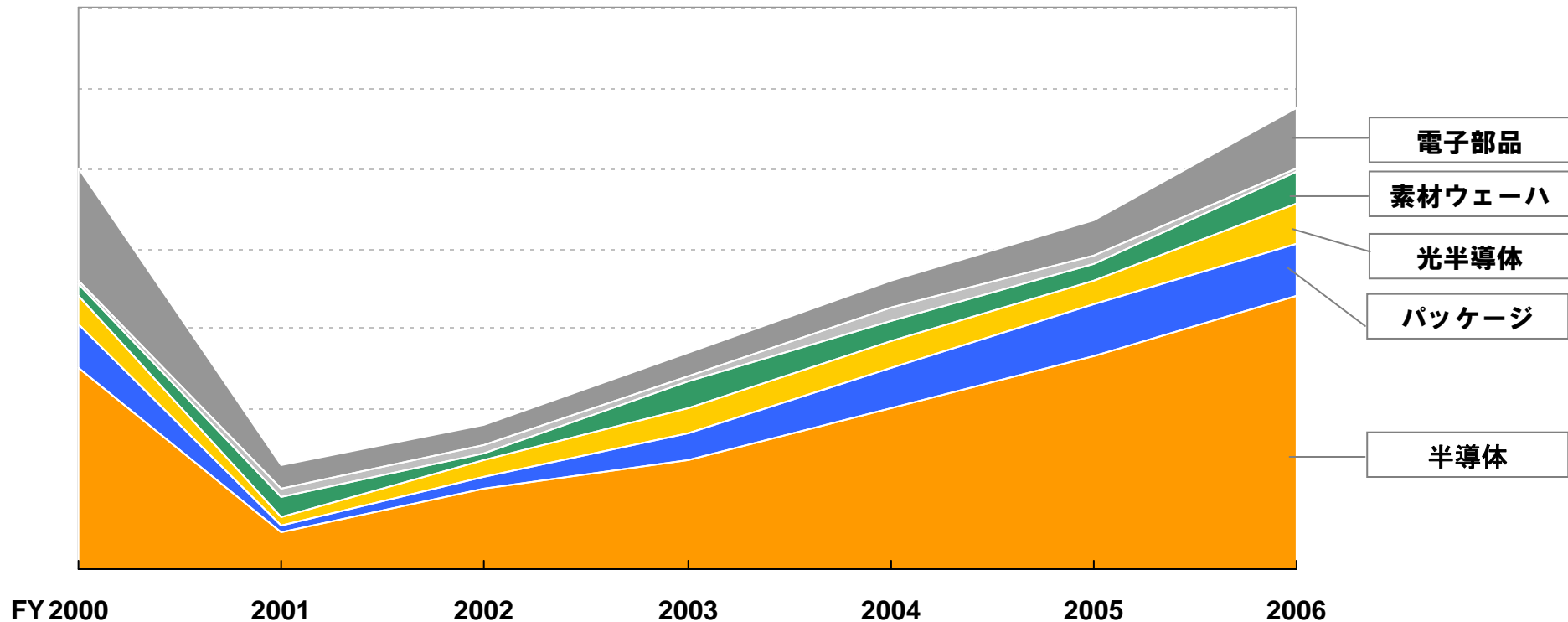
グラインダ
グラインダポリッシャ
サーフェスプレーナー



注: 会計年度中、5台以上売上があったモデル総数

KKM領域の拡大

アプリケーション別 装置売上推移



- 電子部品は2000年の水準を越えず
- 半導体向けは、薄化・ストレスリリース用装置が牽引
- パッケージシンギュレーション・素材ウェーハなど、ディスコならではのアプリケーションを提供し、着実に売上規模が拡大

技術領域の拡大

【装置】



【プロセス】



【精密加工ツール/消耗品】



2003

2004

2005

2006

新製品

DFL7340/7360



- 浜松ホトニクスと提携し、ステルスダイシング技術を利用したレーザーソー

DFL7260



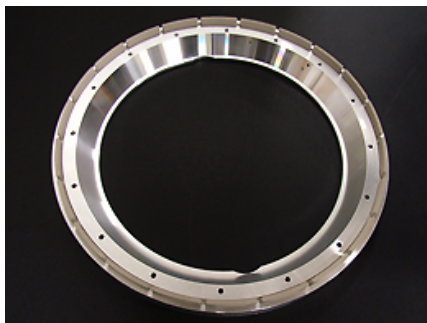
- 2つのレーザーヘッドが搭載可能
- Low-kグルーピング+シリコンフルカットなど多様なアプリケーション

DFD6362



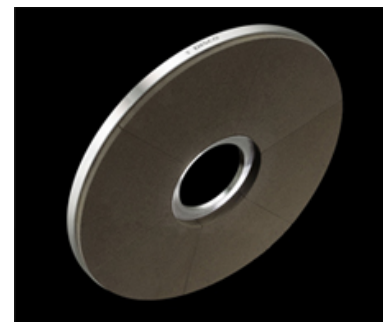
- 300mm量産用ダイサーDFD6361の生産性を更に向上
- 無人化・高稼働率を可能にするAuto Blade Changer (ABC)を搭載可能

UltraPoligrind



- 50 μ m厚以下のウェーハ薄化をターゲットとし、ゲッターリング効果を十分に得ながら、チップ強度も維持するストレスリリース工程における新たなソリューション

DP08

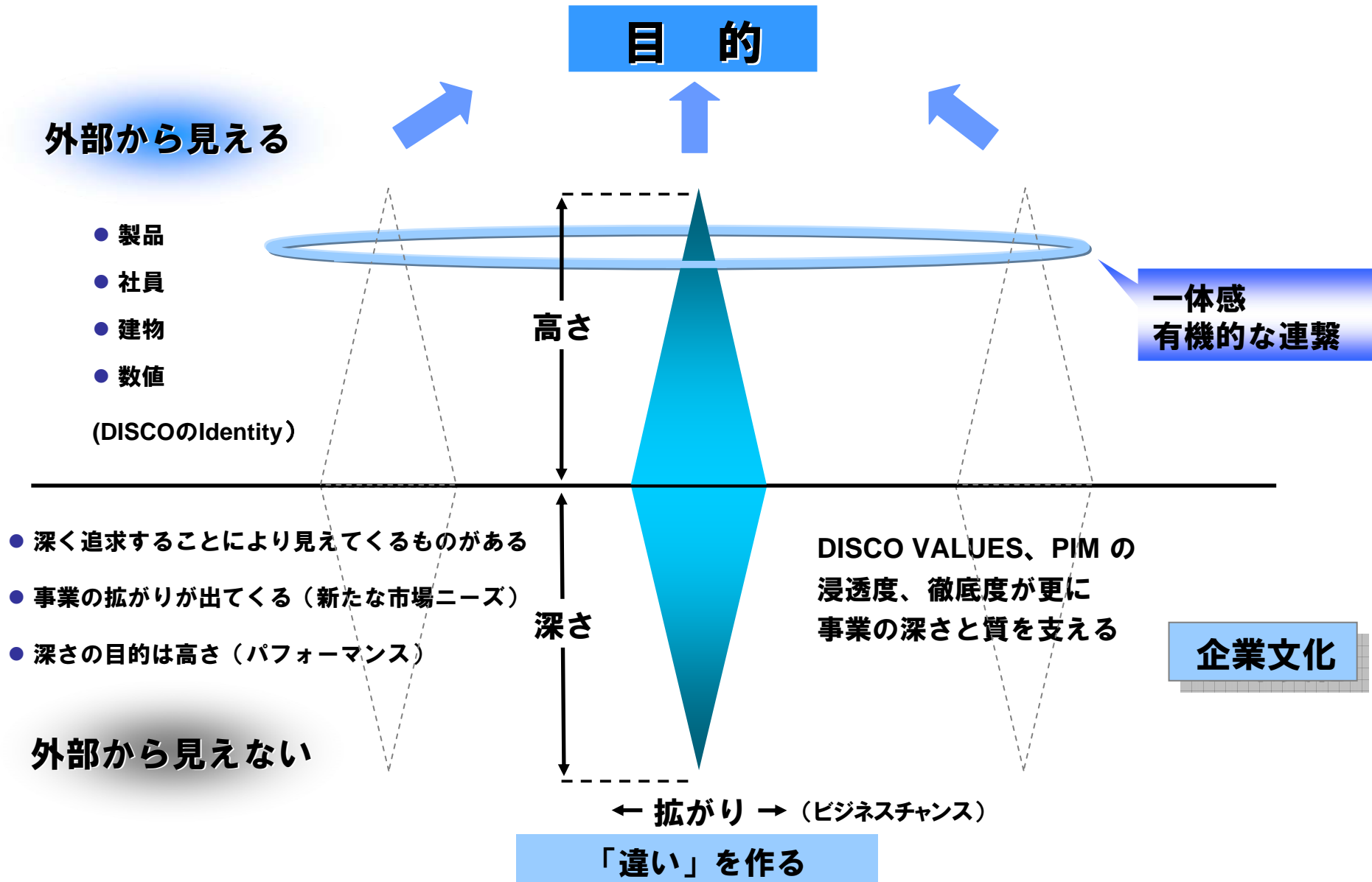


- ケミカルフリーでストレスリリースを実現するドライポリッシングホイール
- DBGプロセスとの融合も可能

トータルソリューション(顧客の認める価値)



事業領域 (Kiru・Kezuru・Migaku)



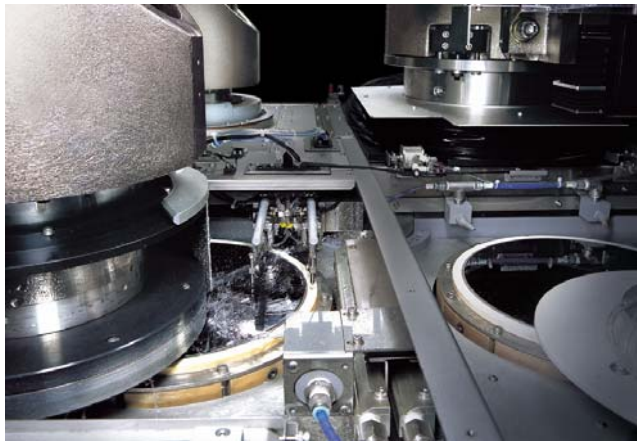
今期の見通しについて

2008年3月期業績予想

(単位: 億円 四捨五入)	中間期	下期予想	通期予想 (11月13日)	【ご参考】 2006年度 通期	対前年比
売上高	461	510	972	861	12.8%
営業利益	110	109	219	195	12.2%
営業利益率	23.9%	21.3%	22.5%	21.9%	0.6pt
経常利益	110	109	219	197	11.4%
経常利益率	23.9%	21.4%	22.6%	22.8%	0.2pt
当期純利益	62	66	128	109	17.0%
純利益率	13.4%	13.0%	13.1%	12.7%	0.4pt

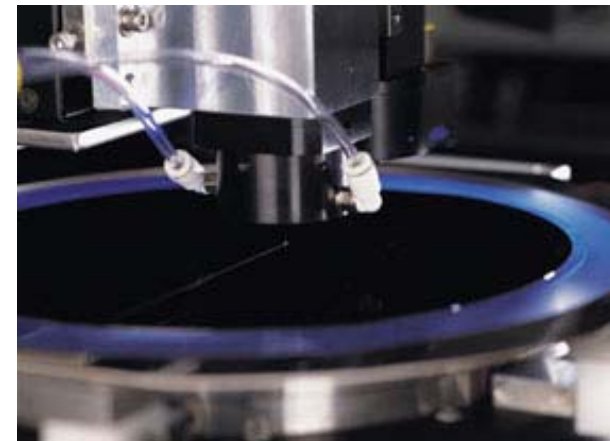
戦略分野の動向

薄化・ストレスリリーフ装置



- メモリーメーカーの投資の手控えもあり、DGPは当初の期待よりも伸びず
- サブコンは薄化用装置の設備投資を活発化
- アプリケーション開発を積極的に行い、高度化する技術ニーズへ対応

レーザー



- Low-kグルーピングの他、LED向け化合物半導体切断用途も拡大の傾向
- 台湾等サブコン向けにも需要拡大
- ダイシングソーで培ったノウハウを活かし、幅広い顧客層へ展開中

新規設備投資

生産効率とBCM対応力向上をめざした設備投資を実施



桑畑工場 精密加工装置及び加工ツールの製造	
投資総額	100億円
着工予定	2008年7月
完成予定	2009年夏
目的	製造現場の集約による効率向上 将来の需要拡大へ対応するための 先行投資 BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造

茅野工場 子会社ダイイチコンポーネンツ製造工場	
投資総額	25億円
着工予定	2008年7月
完成予定	2009年夏
目的	作業効率の向上 BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造

配当について

	中間期	期末	記念配当	年間
2008年3月期(予想)	35円	41円	-	76円
(ご参考) 2007年3月期(実績)	30円	35円	10円	75円

【配当方針】

- ①連結業績に連動した配当（配当性向20%）
- ②安定配当として最低20円の配当金を維持。
ただし3期連続で連結純損失の場合を除く。
- ③赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*2)を超過した場合は、上記①に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする

【注】2007年3月期末時点予定必要資金額 300億円
現預金残高が予定必要資金額を超過しないため配当金の上乗せはなし

本日の説明

1. 2008年3月期中間決算概要

常務取締役 IR担当

関家圭三

2. 事業の展開と今期の見通し

代表取締役社長

溝呂木 齊

3. 質疑応答

DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies

